



# Crème à braser IF 9009<sup>LT</sup>

INTERFLUX®  
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique IF 9009<sup>LT</sup>

Ver: 3.11 02-10-15

Page 1

## Crème à braser activée sans plomb et sans nettoyage

### Description

La crème à braser **IF 9009<sup>LT</sup>** est une crème activée sans nettoyage qui est très performante sur des surfaces fortement oxydées et les surfaces avec une brasabilité limitée.

**IF 9009<sup>LT</sup>** possède un bon pouvoir d'adhésion et une très bonne qualité de sérigraphie. Elle conserve ses propriétés rhéologiques pendant la sérigraphie ce qui permet d'avoir un process de sérigraphie stable.

La crème à braser ne contient pas de colophane ainsi il y a moins de vapeurs nocives et moins d'entretien du four. Les résidus après refusion sont clairs. Les résidus ne perturbent pas les tests par « flying probe » et les tests « in situ ».

**IF 9009<sup>LT</sup>** est hydrophobe et ne forme pas de microbilles après refusion.

La crème à braser **IF 9009<sup>LT</sup>** contient peu d'halogènes et est classée RE L1 suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle



### Plus d'informations:

Profil de refusion	P. 2
Recommandations sur le profil	P. 2
Manipulation	P. 3
Résultats des tests	P. 3
Recommandations pour les paramètres	P. 4

### Avantages:

- Bon mouillage sur les surfaces avec une brasabilité limitée
- Bon mouillage sur les surfaces fortement oxydées
- Résidus clairs après refusion

## Disponibilité

alliages	pourc. metal.	granulométrie	conditionnement
Sn96,5Ag3Cu0,5			
Sn95,5Ag3,8Cu0,7	sérigraphie: 88%-89%	Standard: classe 3 (25— 45µ)	pot :250g/500g cartouche:
Sn95,5Ag4Cu0,5			
Sn99Ag0,3Cu0,7	Dosage:	Les classes 4 et 5 sont disponibles pour certains al- liages	6Oz: 500g/600g/700g 12Oz: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg seringue: 5CC/10CC/30CC
Sn98,5Ag0,8Cu0,7	84%		autres conditionnements sur demande
Sn95,8Ag4,2			
Sn99,3Cu0,7			
Autres alliages sur demande			



## Profil de refusion pour les alliages SAC, SnCu et SnAg

### En général

En général, un profil de refusion avec un palier limité est recommandé. Des profils linéaires et avec un palier sont également possibles. Un profil avec palier peut être utilisé afin de limiter les différences de températures du

circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants, ou bien, pour diminuer la présence de "voids". Quand vous brasez une carte avec de la crème à braser sans plomb, faites attention à ne pas surchauffer les composants, en

particulier quand vous utilisez de la convection ou de l'infrarouge. Il est important de connaître les limites de températures de vos composants. Pour avoir une bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, contrôlez votre profil de refusion avec

des thermocouples. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en températures situés sur les côtés, au milieu et à proximité des gros composants.

## Recommandations pour le profil (alliages SnAgCu, SnCu et SnAg)

### Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à environ 200°C une pente de 1-3°C/s est conseillée. Des montées en températures plus élevées peuvent détruire des composants en raison de l'humidité absorbée.

### Palier

A partir de 180°C jusqu'à environ 215°C avec une pente de 0-1°C/seconde. Dans certains cas un palier avec une température stable est utilisé pour rendre homogène les différences de températures sur la carte ou

afin de réduire la présence de "voids". Pour cela, généralement un palier de 20s à 90s. entre 200°C et 215°C est utilisé.

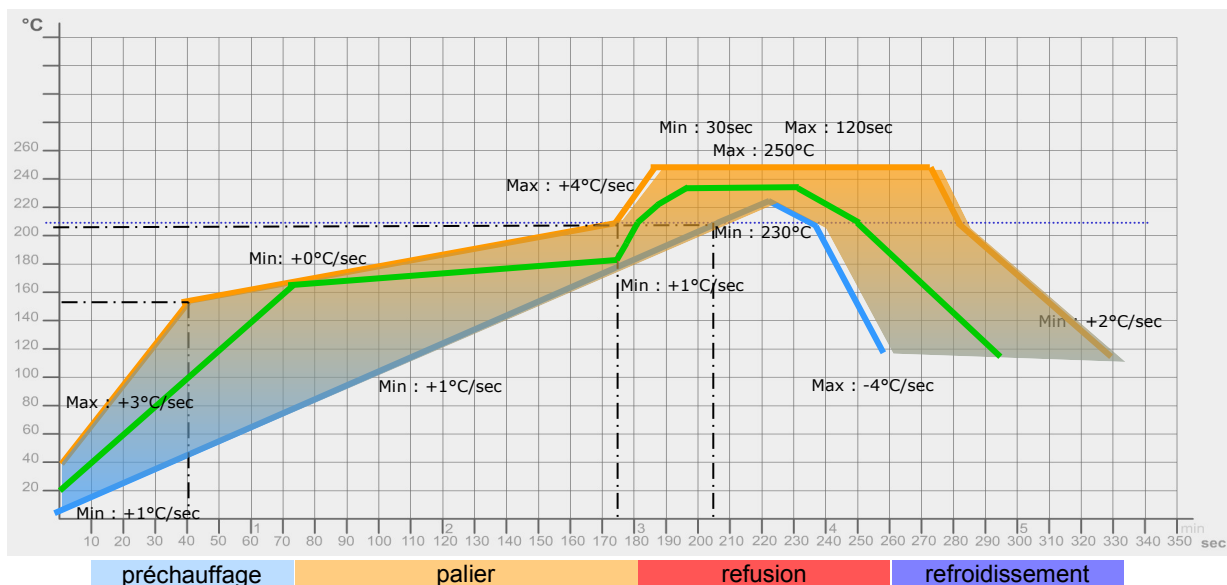
### Refusion

Le pic de refusion dépend des spécifications des composants. En général entre

235°C et 250°C. Le temps au dessus du liquidus est en général entre 45 et 90s.

### Refroidissement

Environ - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des composants.





## Manipulation

### Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 3° - 7°C.

### Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger avant toute utilisation.

### Sérigraphie

Assurer une bonne étanchéité entre la carte et le pochoir. N'appliquer pas plus de pression sur les racles que nécessaire, le pochoir après la sérigraphie doit être propre. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la crème à intervalle régulier.

### Entretien

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie. Le produit de nettoyage **ISC8020** est recommandé en lingettes ou en forme liquide.

### Réutiliser la crème

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un test de sérigraphie et refusion avant toute utilisation en production.

### Sécurité

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

## Résultats des tests de fiabilité

Conforme à la norme EN 61190-1-2(2002) et IPC J-STD-004A/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
<b>Chimique</b>		
Miroir de cuivre	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Argent chromate (Cl, Br)	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
<b>Environnement</b>		
Test SIR	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Propriétés	Résultats	Méthodes
<b>Mécanique</b>		
Test de microbilles	après 15min	<b>préférentiel</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
	après 4h	<b>acceptable</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Test de mouillage		<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Test d'effondrement	après 15min à 25°C	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	après 10min à 150°C	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
Test de propagation	137,89 mm <sup>2</sup>	J-STD-004 IPC-TM-650, 2.4.46



## Recommandations et paramètres d'utilisation

Vitesse de sérigraphie: 20—70mm/sec  
Pression sur les racles: ±250g /cm  
Cycle de nettoyage du pochoir: Toutes les 10 cartes  
Température: 15°C to 25°C  
durée du pouvoir collant ('tack time'): >4 heures  
Refusion  
Profil de refusion: linéaire et palier  
Type de chauffe: convection, phase vapeur...  
Test "in situ": appropriée pour: "flying probe"  
Planche à clous

### Nettoyage

Pour le nettoyage de la crème du pochoir et outils Interflux® **ISC 8020** est recommandé.

Les résidus après refusion de la IF9009<sup>LT</sup> sont très fiables et sans nettoyage mais peuvent être nettoyés si cela est désiré.

Une liste de la compatibilité des produits Interflux® avec les produits de nettoyage Zestron® est disponible chez Interflux.

Nom commercial du produit : IF 9009lt No-Clean, Lead Free Solder Paste

### CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

**INTERFLUX®** ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

[www.interflux.com/fr](http://www.interflux.com/fr)

Le document dans une autre langue?:

[www.interflux.com](http://www.interflux.com)